

# 厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室文件

厦集成电路办〔2019〕6号

## 厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室 关于申报集成电路产业高端人才的通知

各有关单位：

根据《厦门市人民政府关于印发加快发展集成电路产业实施意见的通知》（厦府〔2016〕220号）、《厦门市人民政府办公厅关于印发加快发展集成电路产业实施细则的通知》（厦府办〔2018〕58号）、《厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室关于印发集成电路产业高端人才评定标准的通知》（厦集成电路办〔2019〕2号）等文件精神，现开展厦门市集成电路产业高端人才申报工作，有关事项通知如下：

### 一、申报要求

申报的高端人才应服务于注册地、经营场所均在厦门市行政

辖区内的，具有独立法人资格，专业从事集成电路领域设计、制造、封测、装备和材料生产及研发等经营活动的集成电路相关企业（单位）（以下简称集成电路企业）。

## 二、支持年度和申报时间

（一）支持年度：2016年6月27日-2018年12月31日期间引进的人才。

（二）申报时间：自本通知发布之日起至2019年12月2日。其中，网上申报截止日期2019年11月28日。

## 三、申报材料

### （一）申报企业基本材料

- 1.《厦门市集成电路产业发展专项资金申请表》（附件1）；
- 2.信用承诺书（附件2）；
- 3.所从事的主营业务资质证明材料复印件（根据企业类型提供材料）：

（1）集成电路设计企业：产品清单、芯片设计版图缩略图、产品外观照片、流片证明（上年度获得厦门市流片补贴资金下达文件或流片合同、流片发票）等，或者集成电路设计企业认定文件、产品获奖证书相关佐证材料；

（2）集成电路制造企业：制造设备清单（包含类型、型号、功能、用途、厂家等信息）、上年度与客户签订的合同及收款发票复印件（若干）、生产车间及厂房照片等相关佐证材料；

(3) 集成电路封测企业：封装测试设备清单（包含类型、型号、功能、用途、厂家等信息）、上年度与客户签订的合同及收款发票复印件（若干）、生产车间及厂房照片等相关佐证材料；

(4) 集成电路装备和材料生产及研发企业：装备、材料清单及说明，生产研发设备清单、上年度与客户签订的合同及收款发票复印件（若干）、生产车间及厂房照片等相关佐证材料；

4. 2016-2018年度经注册会计师审计的企业财务报表复印件，及企业完税证明复印件（可根据企业实际申报项目发生年度提供相应材料）。

## （二）申报人条件及要求

### 1. 申报条件

(1) 属2016年6月27日起新引进的（对于非首次调入的人员，应在最近一次调入后在厦工作3年以上）；

(2) 相应从业经历、专业资历属于集成电路领域，且在我市集成电路企业任职，与用人单位签订5年以上劳动合同；

(3) 符合《厦门市集成电路产业高端人才评定标准(试行)》（附件3）所要求的资格条件之一的。

### 2. 申报材料：

(1) 《厦门市集成电路产业高端人才申报书》（附件4）。

(2) 身份证（境外人员提供护照、台胞证等有效身份证件）、学位证书、劳动合同复印件；个人社保缴费情况证明、个人所得

税明细申报情况清单。国（境）外人才须提供合法的入境证明和出入境记录。

（3）符合《厦门市集成电路产业高端人才评定标准（试行）》相应人才类别（A、B、C类）资格条件的相关证明材料。包括但不限于已获得人才认定的文件复印件；专业技术职务资格证书、聘书复印件；所获奖项、荣誉、职称、专利、论文等。外文材料需提供翻译件。

说明：1. 非首次调入的人员，应在学历、专业技术职称、科研成就、从业经历等方面有明显提升的。

2. 半导体公司排名须参照国际级研究机构IC Insights、Trendforce、Gartner、IDC或IHS、中国半导体行业协会、台湾半导体产业协会发布的最新年度企业排名，证明材料需提供网络截图及链接，注明企业排名次序。

3. 集成电路重点企业年度销售额以企业所得税汇算清缴签证报告为准；

4. 市工信局将采取竞争性专家评审方式组织认定。

#### **四、申报程序**

##### **（一）网上申报**

申报单位登陆“i厦门一站式惠民服务平台”（<http://www.ixm.gov.cn/>）-“i工信”-“资金类项目申报”，注册法人账号，登录后选择所要申报的项目类别，按要求填写项目

申请表并根据系统所列要求上传申报材料（操作过程中如有疑问，可点击右上角“帮助”，下载“厦门市工信局一体化综合信息管理平台用户操作手册”）。

## （二）提交纸质材料

网上审核通过后，申报单位于2019年11月28日之前，报送纸质材料两份（正本一份、副本一份），纸质版须与电子版保持一致。

1. 纸质材料编制要求。按照申报企业基本材料、申报人申报材料顺序编制、装订：

（1）基本材料：《厦门市集成电路产业发展专项资金申请表》、信用承诺书、所从事的主营业务资质证明材料复印件、年度企业财务报表复印件、年度企业完税证明复印件。

（2）申报材料：按照申报人顺序编制材料，每名申报人的申报书、身份证及相关佐证材料应编制在一起。

2. 装订须知。申报表首页作封面，纸质材料纸皮胶装，材料侧面标注企业名称。纸质材料加注目录、页码（可手写）。纸质材料一律用A4纸打印或复印清楚，尽量采用双面打印。申报书、及相关复印件须加盖单位公章，整份材料加盖骑缝章。

## （三）受理纸质材料

厦门市工业和信息化局电子信息处

地 址：厦门市思明区湖滨北路61号市政府东楼801

咨询电话：2896743/2896758/2896779

## 五、其他事项

申报个人和单位、财务审计机构不涉及市财政资金使用管理失信惩戒范围，无涉黑涉恶问题。

- 附件：1. 厦门市集成电路产业发展专项资金申请表  
2. 申报汇总表  
3. 信用承诺书  
4. 厦门市集成电路产业高端人才评定标准（试行）  
5. 厦门市集成电路产业高端人才申报书

厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室

(代)

2019年11月13日

(此件主动公开)

---

抄送：市集成电路产业发展工作领导小组办公室成员单位。

---

厦门市工业和信息化局办公室

2019年11月13日印发

---

附件 1

厦门市集成电路产业发展专项资金  
申报表  
(纸质材料封面)

企业名称: (盖章) \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_

联系方式: \_\_\_\_\_

申请日期: \_\_\_\_\_

## 一、企业基本情况

基本信息	企业名称			
	企业法人		身份证号	
	通讯地址			
	注册资金（万元）		开业时间	
	营业执照注册号		所属行业	
联系人信息	姓名		职务	
	办公电话		移动电话	
	姓名		职务	
	办公电话		移动电话	

说明：1. 所属行业：设计、制造、封装、测试、设备、材料等。

2. 通讯地址为企业实际经营场所地址。

## 二、企业经营情况（201\_年度）

单位：万元

总体情况	总产值/销售收入		主营业务收入		净利润	
税收情况	税收总额		企业所得税		增值税	
	应缴	减免	应缴	减免	应缴	退税
研发费用	研发费用总额		占企业销售（营业）收入比例（%）	在中国境内发生的研发费用	占研发费用总额比例（%）	
人员构成	当年职工总数	本科以上学历职工人数	占当年职工总数比例（%）	本科以上学历的研发人员数	占当年职工总数比例（%）	

注：人员构成以申报年度 12 月份数据为准



### 三、申报项目汇总表

序号	申报项目名称	申请金额（万元）

### 四、已享受财政资金补助情况

序号	补助年度 (2016-2018年)	项目名称	享受补助金额（万元）	项目基本情况



附件 3:

## 信用承诺书

本人承诺所有申报材料真实，不属于失信被执行人、联合惩戒、重大税收违法对象。如若违反以上承诺，自愿放弃项目申报或退还所获资金，并承担由此造成的一切法律责任。授权并同意厦门市工业和信息化局查询本人信用报告等相关资信情况。

申报人（签字）：\_\_\_\_\_（单位盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_



# 厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室文件

厦集成电路办〔2019〕2号

---

## 厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室 关于印发集成电路产业高端人才评定标准的通知

各成员单位：

根据《厦门市人民政府关于印发加快发展集成电路产业实施意见的通知》（厦府〔2016〕220号）精神，为进一步完善我市集成电路产业发展的政策措施，推动产业高端人才引进，经报市政府同意，现印发《厦门市集成电路产业高端人才评定标准（试行）》，请认真组织实施。

厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室

（代）

2019年5月6日

## 厦门市集成电路产业高端人才评定标准（试行）

本标准所称的集成电路产业高端人才，是指由厦门市集成电路产业发展工作领导小组（简称“IC领导小组”）按照本标准审核确认的集成电路领域各类各级人才。以政府雇员、政府特聘专家等形式引进的，可按条件和程序确定为集成电路产业高端人才，并享受相关待遇。

本标准中所有奖项、荣誉、职称、成果和薪金收入等的获得都必须源于集成电路领域的成就与贡献。

本标准所述集成电路产业高端人才，是指 2016 年 6 月 27 日起新引进的（对于非首次调入的人员，应在最近一次调入后在厦工作 3 年以上，以在厦缴纳社保及个人所得税时间为准），相应从业经历、专业资历属于集成电路领域，且在我市集成电路企业任职，与用人单位签订 5 年以上劳动合同的人才。所在用人单位应为注册地、经营场所均在厦门市行政辖区内，具有独立法人资格、无违法违规行为、专业从事集成电路设计、制造、封测、装备和材料生产及研发等经营活动的相关企业（单位）。

厦门市集成电路产业高端人才由厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室（以下简称“IC办”）定期采取竞争性专家评审方式组织认定。经 IC 领导小组认定后，享受《厦门市加快发展集成电路产业实施细则》中相应人才政策。具体评定标准如

下：

厦门市评定集成电路高端人才分为 A 类人才（领军人才）、B 类人才（核心人才）、C 类人才（骨干人才），各类引进高端人才应符合的资格条件为：

### 一、A 类人才（领军人才）

依据《福建省引进高层次人才评价认定办法（试行）》（闽委人才〔2015〕5 号）引进高层次人才标准，由福建省认定为 A 类引进高层次人才，且相应从业经历、专业资历属于集成电路领域，可由 IC 领导小组优先认定为厦门市集成电路 A 类人才（领军人才）。

此外，熟悉国际半导体领域发展情况，在前沿研究、产业发展等方面取得突出成绩，对促进集成电路产业发展做出杰出贡献，且符合以下条件之一及以上者，可优先认定为 A 类人才（领军人才）。

1. 在全球前 50 大半导体公司担任过董事会成员、首席科学家、首席技术官或技术研发负责人或其他相应职务及以上并累计工作 3 年以上者。

2. 在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封装测试、装备等子行业全球前 25 大公司内担任过董事会成员、首席科学家、首席技术官或技术研发负责人或其他相应职务及以上累计 3 年以上者。

3. 在集成电路材料（硅片、光罩材料等）、电子设计自动化（EDA）等行业全球前 10 大公司内担任过董事会成员、首席科学家、首席技术官或技术研发负责人或其他相应职务及以上累计 3 年以上者。

4. 在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封装测试、装备、材料等子行业大陆或台湾前 20 大公司担任过董事会成员、首席科学家、首席技术官或技术研发负责人或其他相应职务及以上累计工作 3 年以上者。

5. 获评中国科学院院士、工程院院士、台湾工业技术研究院院士，以及长江学者、千人计划等国家级人才项目。

6. 国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程（技术）研究中心、国家企业技术中心主任，以及国家重点实验室、国家工程实验室学术委员会主任，或国家工程（技术）研究中心等工程学术（技术）委员会主任，任期内考核结果为合格者。

## 二、B 类人才（核心人才）

依据《福建省引进高层次人才评价认定办法（试行）》（闽委人才〔2015〕5 号）引进高层次人才标准，由福建省认定为 B 类引进高层次人才，且相应从业经历、专业资历属于集成电路领域，可由 IC 领导小组优先认定为厦门市集成电路 B 类高端人才。

此外，熟悉国际半导体领域发展情况，在前沿研究、产业发



展等方面取得较大成绩，对促进集成电路产业发展做出较大贡献，且符合以下条件之一及以上者，可优先认定为核心 B 类高端人才。

1. 在全球前 50 大半导体公司担任过一级业务部门的部门负责人、技术负责人或其他相应职务及以上者累计 3 年以上者。

2. 在集成电路设计、制造、集成器件制造 (IDM)、封装测试、装备等子行业全球前 25 大公司内担任过一级业务部门的部门负责人、技术负责人或其他相应职务及以上者且累计工作 3 年以上者。

3. 在集成电路材料 (硅片、光罩材料等)、电子设计自动化 (EDA) 工具软件全球前 10 大公司担任过一级业务部门的部门负责人、技术负责人或其他相应职务及以上者且累计工作 3 年以上者。

4. 在集成电路设计、制造、集成器件制造 (IDM)、封装测试、装备、材料等子行业大陆或台湾前 20 大公司担任过一级业务部门的部门负责人、技术负责人或其他相应职务及以上者且累计工作 3 年以上者。

5. 在我市集成电路重点企业担任分管技术研发部门的副总级以上高级职务，且用人单位支付年薪达到全市上年度城镇单位在岗职工平均工资 8 倍以上。

6. 厦门市集成电路领域“双百计划”海外高层次人才及 B

类以上领军型创业人才，项目须落地实现产业化。

### 三、骨干人才（C类人才）

依据《福建省引进高层次人才评价认定办法（试行）》（闽委人才〔2015〕5号）引进高层次人才标准，由福建省认定为C类引进高层次人才，且相应从业经历、专业资历与集成电路领域相关，可由IC领导小组优先认定为厦门市集成电路C类高端人才。

此外，熟悉国际半导体领域发展情况，在前沿研究、产业发展等方面取得一定成绩，对促进集成电路产业发展做出一定贡献，且符合以下条件之一及以上的，可优先认定为厦门市集成电路骨干人才（C类人才）包括：

1. 在全球前50大半导体公司担任过二级业务部门的部门负责人、技术负责人或其他相应职务及以上者累计3年以上者。

2. 在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封装测试、装备等子行业全球前25大公司内担任过二级业务部门的部门负责人、技术负责人或其他相应职务及以上者且累计工作3年以上者。

3. 在集成电路材料（硅片、光罩材料等）、电子设计自动化（EDA）工具软件全球前10大公司担任过二级业务部门的部门负责人、技术负责人或其他相应职务及以上者且累计工作3年以上者。

4. 在集成电路设计、制造、集成器件制造 (IDM)、封装测试、装备、材料等子行业大陆或台湾前 20 大公司担任过二级业务部门的部门负责人、技术负责人或其他相应职务及以上者且累计工作 3 年以上者。

5. 在国家鼓励的集成电路企业、国家高新技术企业担任一级业务部门负责人、技术负责人或其他相应科研技术职务及以上累计 3 年以上者。

6. 在中国科学院、工程院、台湾工业技术研究院, 中国电子科技信息集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团等单位直属研究所的科研、技术、工程等二级部门担任副负责人、副技术负责人或其他相应职务及以上累计 3 年以上者, 期间主持或参与过国家级重大重点项目 (排名前 5), 主持经费 1000 万元以上。

7. 在省级知识产权优势企业担任一级科研、技术、工程等业务部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应科研技术职务及以上累计 3 年以上者。

8. 在我市集成电路重点企业担任技术研发部门负责人, 且用人单位支付年薪达到全市上年度城镇单位在岗职工平均工资 6 倍以上。

9. 厦门市集成电路领域“双百计划”C 类领军型创业人才, 项目须落地实现产业化。

#### 四、备注说明

1. 全球前 50 大半导体公司；集成电路设计、制造、集成电路器件制造（IDM）、封测、装备等子行业全球前 25 大公司或大陆、台湾前 20 大公司；集成电路材料（硅片、光罩材料等）、电子设计自动化（EDA）工具软件全球前 10 大公司。名单参照国际级研究机构 IC Insights、Trendforce、Gartner、IDC 或 IHS、中国半导体行业协会、台湾半导体产业协会发布的最新年度企业排名。

2. 国家鼓励的集成电路企业名单、国家（省级）知识产权优势企业名单、高新技术企业名单以相关部门发文公布的最新版为准。

3. 集成电路重点企业是指年度销售额超过 2000 万元的集成电路设计企业，及收入超过 1 亿元的集成电路企业（集成电路设计企业除外）。

4. 本标准中的“以上”包括本级（本数）。

5. 上述分类目录，适时更新完善。

6. 本标准自发布之日起施行，发布实施后，将适时根据实际运行情况及集成电路重点鼓励业态的变动予以相应调整。具体由市 IC 办负责解释。

编号\_\_\_\_\_

## 厦门市集成电路产业高端人才申报书

申报人\_\_\_\_\_ (中文) \_\_\_\_\_ (英文或拼音)

申报单位\_\_\_\_\_

申报人是否已

在厦门工作\_\_\_\_\_ 工作时间\_\_\_\_\_

专业领域\_\_\_\_\_

专业方向\_\_\_\_\_

联系人\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_ (办公) \_\_\_\_\_ (手机)

申报日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室

姓名	中文		性别		
	英文		出生年月		
国籍		户籍			
身份证号码 (护照号码)		联系地址			
电话		E-Mail			
首次来厦工作时间 (年月)		合同期限			
申请人才类别	A类( ) B类( ) C类( )		对应条件		
最高学历学位情况	-----	学位	毕业院校	专业	
	中文				
	英文				
来厦前	-----	工作单位		职务	
	中文				
	英文				
<b>教育经历</b>					
(按时间顺序从本科填起, 若为国外教育请加注英文)					
学位	开始年月	结束年月	国家	院校	专业
<b>工作经历</b>					
(按时间顺序填写, 兼职请注明, 若为国外工作请加注英文)					
职务	开始年月	结束年月	国家	单位	



(3) 其他近五年的显著业绩表现 (200 字以内)

4、近五年领导创新团队、建设学术梯队、培育青年人才情况

5、其他(包括近五年获得的重要奖项、在国际学术组织兼职、在国际学术会议做重要报告等情况) (300 字以内)

用人单位有项目协议、工作计划、工作目标

1、工作目标及内容 (包括来厦后主要研究、研发内容与目标, 主要突破的核心问题及产业核心技术等)

2、工作方式及进度安排 (包括来厦的主要工作方式, 如全职或兼职, 每年在厦的时间安排, 对工作目标和内容的进度安排等)



3、创新性描述（包括所研究领域创新性的描述，其在国内外的主要现状和趋势，研究课题对厦门相应学科、产业的意义和作用等）

4、现有基础（现有的团队、技术基础，拥有的自主知识产权状况、成果的关键核心技术，现有的研发资金情况，团队主要成员情况等）

5、预期贡献（研究课题预计产生的经济和社会效益）

6、所需支持（希望得到的进一步支持，包括资金、政策等方面的支持）

您是否和其他任何单位签订过仍然有效的竞业禁止协议，如果有，请列出。（200字以内）

<b>用人单位意见</b>
1、推荐理由(300字以内)
2、支持条件(包括工作和生活等方面)(200字以内)
申报人有关信息属实,本单位承诺予以上述支持,特推荐申报“厦门市集成电路高端人才”。
<p style="text-align: center;">主要负责人签</p>
<p style="text-align: center;">单位(公章)</p>
<p style="text-align: right;">年 月 日</p>

<b>专家评审意见</b>
<p style="text-align: center;">专家组签字:</p>
<p style="text-align: center;">年 月 日</p>
说明: 1. 对应条件指满足《厦门市集成电路产业高端人才评定标准》A、B、C三类人才规定具体条件,申报人需提供相应依据。 2. 境外人才需每年在境内居住满183天。